

產品: 肉桂捲

目標: 用探棒穿刺測量肉桂捲(不加糖霜)的硬度

動作模式: 穿刺測試

測試模式:

速度	測試模式	啟點	目標	延遲
1.7 mm/s	距離(壓)	20 gf	6.2 mm	0 sec

配件:

直徑 25mm 柱形探頭(壓克力)、測試台

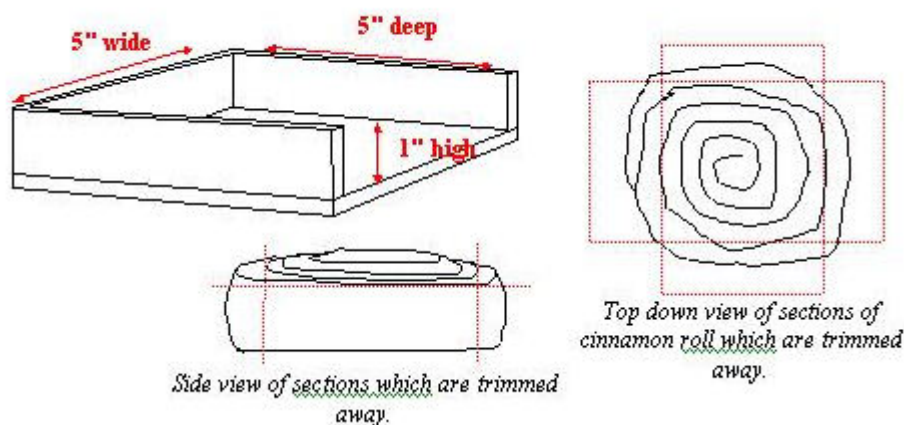
樣品準備:

將肉桂捲用聚乙烯袋雙層包裹，並在室溫下保存直至進一步測試。在烘焙後的第 3、7、10 和 14 天對肉桂捲進行測試。在每個測試日期，對每個變數的兩個烤盤（每個烤盤 9 個肉桂捲）進行評估。將單一肉桂捲分開，切掉四個邊，然後放入一個盒壁高 1 英吋的塑膠盒中。每個肉桂捲的頂部都修剪至盒壁的高度。1 吋厚

實驗設置:

將每個蛋糕樣本放置在探頭正下方，然後開始測試。只有在所有蛋糕樣本測試完成並存檔後，才進行分析。

曲線圖:



計算項目:

☒最大正力

結果:

記錄峰值力。計算 18 次重複測試的平均值和標準差。

備註:

- 本方法源自於一系列使用質構分析儀測試常見烘焙產品質構的程序。這些程序由美國烘焙協會 (AIB) 位於堪薩斯州曼哈頓的實驗烘焙實驗室開發並投入使用。
- AIB 研究人員的理念是發展極為靈活的質構測試方案。烘焙產品的種類和形狀多種多樣，因此，有意義的質構比較必須考慮不同的產品幾何形狀。這些測試程序通常透過將產品尺寸縮小到公分母來處理幾何形狀的差異。
- 通常，大多數此類測試的目標是測量烘焙產品的硬度和保質期。由於這些方案主要涉及樣品處理，因此如果測試目標不同（例如彈性、黏結性、回彈性等），可以且應該對其進行略微修改。
- 這些方案只是開發適合您自己產品的測試方法的起點。研究人員應該能夠輕鬆地修改樣品處理方案、測試速度和距離，以適應任何特定目的。